



MID-Förderpreis

der Forschungsvereinigung
Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.

Ausschreibung 2021

1. Präambel

Die Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V. verleiht den *MID-Förderpreis* an Absolventen/innen von Hochschulen für wegweisende wissenschaftliche Arbeiten zur MID-Technologie. Der Preis ist mit einer Urkunde und 1.000,- € dotiert.

Räumliche Spritzgegossene Schaltungsträger (Molded Interconnect Devices – MID) sind strukturiert metallisierte Grundkörper mit integrierten Leiterzügen. Die hohe Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der Formgebung sowie der strukturierten Metallisierung eröffnet vielfältige Potenziale zur Herstellung hochintegrierter mechatronischer Produkte. Zur Förderung und Weiterentwicklung dieser Technologie wurde im Herbst 1992 die gemeinnützige Forschungsvereinigung 3-D MID e.V. gegründet. Mitglieder sind derzeit 73 Unternehmen und 32 Hochschul- und Forschungsinstitute aus allen MID-relevanten Fachbereichen.

2. Vergabe-Richtlinien

Mit dem *MID-Förderpreis* der Forschungsvereinigung werden Absolventen/innen von Hochschulen ausgezeichnet, die eine hervorragende wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der MID-Technologie angefertigt haben. Hierzu zählen insbesondere die Bereiche:

- 1. Innovationen in MID:**
Integrative Produktkonzepte; wirtschaftliche Aspekte; Markterschließung
- 2. MID – Anwendung und Realisierung:**
Erweiterter Nutzen durch MID; Auswahl von MID-Herstellungsverfahren; Strategien für erfolgreiche MID-Projekte
- 3. Integrierte CAD/CAM-Systeme:**
Entwicklungssysteme ECAD/MCAD; 3D-MID-Layout und Design; Simulation
- 4. Materialien für MID:**
Einsatz neuer Substrate; Schaltungsträger-Oberflächen; Verbindungsmedien
- 5. Herstellungsverfahren:**
Kunststoffverarbeitung; Metallisierungsverfahren; Strukturierung von Leiterbahnen

6. Aufbau- und Verbindungstechnik:

Bestücken: SMT, THT, Chip on MID; alternative Lötverfahren, Leitleben;
Systemlösungen für MID

7. Qualitätssicherung:

Qualitätssichernde Maßnahmen; Umweltschutz, Recycling; Prüfmethodik, Standards

8. Zukünftige Entwicklungen:

Drucktechnologien; alternative Aufbautechnologien; Rapid Prototyping/Manufacturing

Die Beiträge sollen von den Fakultäten und Fachbereichen der Hochschulen angenommene wissenschaftliche Arbeiten der letzten 2 Jahre sein. Jede einzureichende Arbeit ist mit einer gutachterlichen Stellungnahme des betreuenden Professors zu versehen.

3. Aufruf zur Bewerbung um den Förderpreis

Die Vorschläge können nur durch die betreuenden Professoren eingereicht werden. Folgende Unterlagen sind den Vorschlägen beizufügen:

- wissenschaftliche Arbeit
- gutachterliche Stellungnahme durch den jeweiligen Hochschullehrer
- Lebenslauf des Bewerbers

Einsendeschluss für die Einreichung ist Freitag, der 6. November 2021.

4. Auswahl der prämierten Arbeiten

Die eingereichten Arbeiten werden durch den Forschungsbeirat der Forschungsvereinigung 3-D MID e.V. beraten und beurteilt. Die Benachrichtigung der Preisträger erfolgt bis zum 1. Dezember 2021. Der *MID-Förderpreis* der Forschungsvereinigung wird im Rahmen des 14. Internationalen Kongresses Molded Interconnect Devices 2021 vom 9. bis 10. Februar 2021 in Amberg verliehen.

5. Einsendung und Rückfragen

Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.

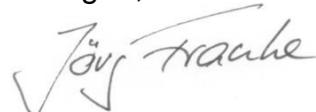
Fürther Straße 246b, 90429 Nürnberg

Tel.: +49 911 5302-9100

Fax: +49 911 5302-9102

E-Mail: info@3dmid.de

Erlangen, den 19. Juni 2020



Prof. Dr. Jörg Franke
1. Vorsitzender



Dr. Ingo Kriebitzsch
Forschungsbeiratsvorsitzender